【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第７部門第２区分
【発行日】平成29年9月7日(2017.9.7)

【公開番号】特開2017-28294(P2017-28294A)
【公開日】平成29年2月2日(2017.2.2)
【年通号数】公開・登録公報2017-005
【出願番号】特願2016-163981(P2016-163981)
【国際特許分類】
Ｈ０１Ｌ　23/15　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　25/065　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　25/07　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　25/18　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　23/522　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/768　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　21/3205　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　23/14　(2006.01)
Ｈ０１Ｌ　23/32　(2006.01)
Ｈ０５Ｋ　3/40　(2006.01)
Ｈ０５Ｋ　1/11　(2006.01)
Ｈ０５Ｋ　3/06　(2006.01)
【ＦＩ】
Ｈ０１Ｌ　23/14　Ｃ
Ｈ０１Ｌ　25/08　Ｄ
Ｈ０１Ｌ　21/88　Ｊ
Ｈ０１Ｌ　23/14　Ｓ
Ｈ０１Ｌ　25/08　Ｇ
Ｈ０１Ｌ　23/32　Ｄ
Ｈ０５Ｋ　3/40　Ｅ
Ｈ０５Ｋ　1/11　Ｈ
Ｈ０５Ｋ　3/06　Ｅ

【手続補正書】
【提出日】平成29年7月31日(2017.7.31)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
第１面と、前記第１面に対向する第２面とを有するガラス基板と、
前記ガラス基板の前記第１面に前記第２面に至らない深さで設けられた開口部に配置された導電性材料と、を有し、
前記導電性材料における前記第２面側の端面が前記ガラス基板で覆われていることを特徴とする基板。
【請求項２】
平面視において、前記ガラス基板の一部は前記導電性材料の前記周縁又は前記周縁の外側に位置し、前記周縁に沿う環状の凸部を有することを特徴とする請求項１に記載の基板。

【請求項３】
第１面と、前記第１面に対向する第２面とを有するシリコンを含む基板と、
前記シリコンを含む基板の前記第１面に前記第２面に至らない深さで設けられた開口部に配置された導電性材料と、を有し、
前記導電性材料における前記第２面側の端面が前記シリコンを含む基板で覆われており、
前記開口部の内壁面に絶縁膜が配置されていることを特徴とする基板。
【請求項４】
平面視において、前記シリコンを含む基板の一部は前記導電性材料の前記周縁又は前記周縁の外側に位置し、前記周縁に沿う環状の凸部を有することを特徴とする請求項３に記載の基板。
【請求項５】
互いに対向する第１面と第２面とを有する基体の前記第１面に、前記第２面に至らない深さで開口部を形成し、
前記開口部を導電性材料で充填し、
前記第２面に、前記導電性材料の内側領域の一部を開口し、前記導電性材料の外側領域および前記導電性材料の周縁を覆うマスクを形成し、
前記マスクが設けられた状態で前記基体の前記第２面をエッチングすること
を特徴とする基板の製造方法。
【請求項６】
前記マスクは環状に形成されることを特徴とする請求項５に記載の基板の製造方法。
【請求項７】
前記エッチングは少なくとも一部に等方性エッチングを含むことを特徴とする請求項５に記載の基板の製造方法。
【請求項８】
前記マスクは前記エッチングが進行するにつれて取り除かれることを特徴とする請求項５に記載の基板の製造方法。